

2020-2026年中国晶圆制造 行业发展态势与市场需求预测报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2020-2026年中国晶圆制造行业发展态势与市场需求预测报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202003/158279.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

2016年我国硅晶圆需求约2807百万平方英寸，占比全球硅晶圆11000百万平方英寸比重约25.51%，近几年我国硅晶圆需求情况如下图所示： 2011-2016年中国硅晶圆需求及占比全球比重 资料来源：中企顾问网整理

2016年我国晶圆行业市场规模约435亿元，同比2015年的383.7亿元增长了13.4%。近几年我国晶圆行业市场规模情况如下图所示： 2011-2016年中国晶圆行业市场规模 资料来源：中企顾问网整理

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录

第一章 晶圆制造简介 21

第一节 晶圆制造流程 21

第二节 晶圆制造成本分析 27

第二章 2019年半导体市场 32

第一节 2019年半导体产业分析 32

第二节 2019年半导体市场上下游状况分析 34

第三节 2019年全球晶圆制造产业现状 35

第四节 2019年全球半导体制造产业 38

一、全球半导体产业概况 38

二、全球晶圆制造行业概况 39

第五节 2019年中国半导体产业与市场 44

一、中国半导体市场 44

二、中国半导体产业 47

三、中国IC设计产业 56

四、中国半导体产业发展趋势 59

第三章 2019年晶圆制造产业简介 61

第一节 晶圆制造工艺简介 61

第二节 全球晶圆产业及主要厂商简介 62

第三节 中国半导体产业政策环境 70

第四节 中国晶圆制造业现状及预测 73

2016年我国硅晶圆需求约2807百万平方英寸，占比全球硅晶圆11000百万平方英寸比重

约25.51%，近几年我国硅晶圆需求情况如下图所示： 2011-2016年中国硅晶圆需求及占比全球比重 资料来源：中企顾问网整理

2016年我国晶圆行业市场规模约435亿元，同比2015年的383.7亿元增长了13.4%。近几年我国晶圆行业市场规模情况如下图所示： 2011-2016年中国晶圆行业市场规模 资料来源：中企顾问网整理

第四章 2019年晶圆制造行业主要企业分析 76

一、中芯国际 76

二、上海华虹NEC电子有限公司 83

三、上海宏力半导体制造有限公司 92

四、华润微电子 99

五、上海先进半导体 106

六、和舰科技（苏州）有限公司 113

七、BCD（新进半导体）制造有限公司 120

八、方正微电子有限公司 127

十、南通绿山集成电路有限公司 134

十一、纳科（常州）微电子有限公司 141

十二、珠海南科集成电子有限公司 150

十三、康福超能半导体（北京）有限公司 157

十四、科希-硅技半导体技术第一有限公司 163

十五、光电子(大连)有限公司 170

十六、西安西岳电子技术有限公司 176

十七、吉林华微电子股份有限公司 183——

十八、丹东安顺微电子有限公司 191

十九、敦南科技 198

二十、福建福顺微电子 205

二十一、杭州立昂 212

二十二、杭州士兰集成电路 219

二十三、HYNIX-ST半导体公司 226——

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202003/158279.html>